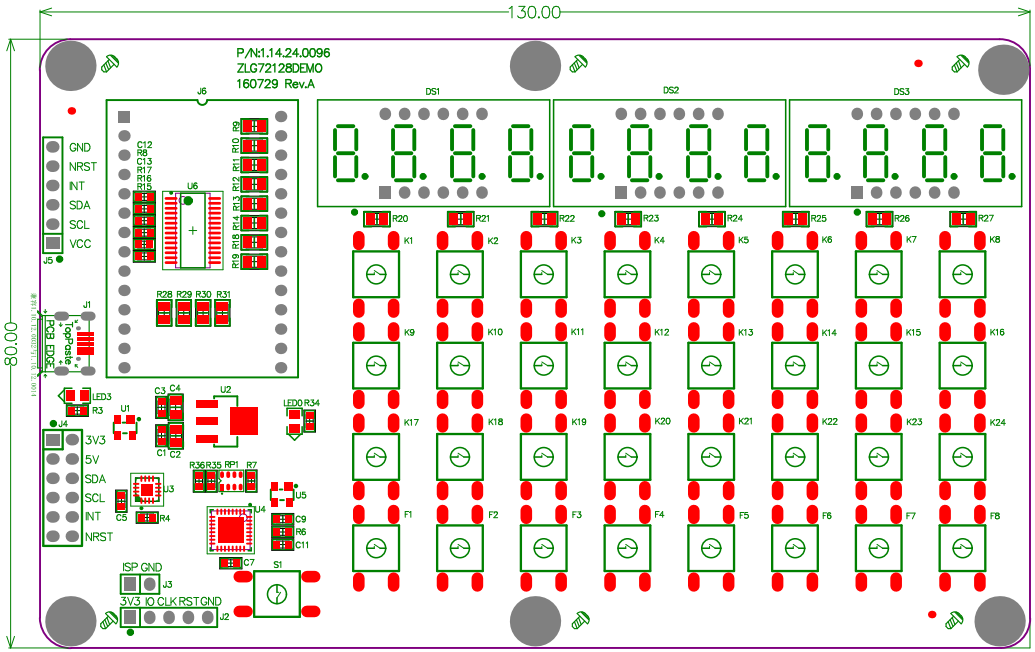

PCB加工工艺要求

尺寸	130 mm x 80 mm								
板材	■FR4 TG140	□FR4 TG170	□生益有胶材料	□MEGTRON6	□其他：				
板层	□单面	■2	□4	□6	□8	□10			
板厚	□0.4mm	□0.6mm	□0.8mm	□1.0mm	□1.2mm	□1.4mm	■1.6mm	□1.8mm	□2.0mm
铜厚	外层（完成铜厚）	□1/2OZ	■1OZ	□2OZ	内层	□1/2OZ	□1OZ	□2OZ	
丝印颜色	■白色	□其他：							
阻焊颜色	■绿色	□黑色	□红色	□蓝色	□黄色	□其他：			
表面处理工艺	■沉镍金	□无铅喷锡	□电镀镍金	□电镀软金	□OSP	□光板			
特殊工艺	■无	□按键镀硬金	□金手指	□半孔工艺	□FPCB补强	□树脂塞孔	□电镀填孔		
是否阻焊塞孔	■是	□否	□按文件						
交货方式	■非拼板	□拼板	□分成单板交货						

Gerber输出：英制、相对零点、抑制前导零、精度2:5
NC Drill输出：英制、相对零点、抑制前导零、精度2:4

其他说明

1. 机械1层(*.GM1)为外形铣边；若存在工艺副边，请在副边上增加分流点
2. 请用供应商UR认证标识(包括认证号，生产周期)替换放置在板上的UR标志；且保持其位置、方向一致；板内无UR标志的，若有工艺副边，可在副边上添加；否则禁止添加。标志样式如右 >>> 94V-0
3. 要求板翘曲度<=0.75%，若无法做到请确认
4. 出货包装内请附上成品检验报告、测试报告等
5. 若存在V-CUT，无特别说明时，必须是双面V-CUT，且余量按以下表格执行

筋厚（余量）	PCB厚度（mm）							
	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3
最小值	0.16	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
最大值	0.32	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8

6. PCB做完后，请高温烘烤进行应力释放，再整平（或重物压板烘烤），防止翘曲

PCB加工工艺要求

尺寸	130 mm x 80 mm		
板材	■FR4 TG140 □FR4 TG170 □生益有胶材料 □MEGTRON6□其他：		
板层	□单面 ■2 □4 □6 □8 □10		
板厚	□0.4mm □0.6mm □0.8mm □1.0mm □1.2mm □1.4mm ■1.6mm □1.8mm □2.0mm		
铜厚	外层（完成铜厚）	□1/2OZ ■1OZ □2OZ	内层 □1/2OZ □1OZ □2OZ
丝印颜色	■白色 □其他：		
阻焊颜色	■绿色 □黑色 □红色 □蓝色 □黄色 □其他：		
表面处理工艺	■沉镍金 □无铅喷锡 □电镀镍金 □电镀软金 □OSP □光板		
特殊工艺	■无 □控阻镀镍金 □金手指 □半孔工艺 □FPCB补强 □树脂塞孔 □电镀填孔		
是否阻焊塞孔	■是 □否 □按文件		
交货方式	■非拼板 □拼板 □分成单板交货		

Gerber输出： 英制，相对零点，抑制前导零，精度2:5

NC Drill输出： 英制，相对零点，抑制前导零，精度2:4

其他说明

1. 机械1层(*.GM1)为外形铣边； 若存在工艺副边，请在副边上增加分流点
2. 请用供商UR认证标识(包括认证号，生产周期)替换放置在板上的UR标志； 且保持其位置，方向一致；
   板内无UR标志的，若有工艺副边，可在副边上添加；否则禁止添加。 标志样式如右 >>> ®
3. 要求板翘曲度<=0.75%，若无法做到请确认
4. 出货包装内请附上成品检验报告，测试报告等
5. 若存在V-CUT，无特别说明时，必须是双面V-CUT，且参量按以下表格执行

成厚（参量）	PCB厚度（mm）							
	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3
最小值	0.16	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
最大值	0.32	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8

6. PCB做完后，请高温烘烤进行应力释放，平整（或重物压板烘烤），防止翘曲